【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成16年10月28日(2004.10.28)

【公開番号】特開2002-329753(P2002-329753A)
【公開日】平成14年11月15日(2002.11.15)
【出願番号】特願2002-127770(P2002-127770)
【国際特許分類第７版】
　Ｈ０１Ｌ　21/60
　Ｈ０１Ｌ　21/607
【ＦＩ】
　Ｈ０１Ｌ　21/60　　３１１Ｔ
　Ｈ０１Ｌ　21/607　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成15年10月17日(2003.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子部品に当接して電子部品を被圧着面に押圧しながら振動を付与して被圧着面に圧着する電子部品のボンディングツールを備えた電子部品のボンディング装置であって、前記ボンディングツールが、振動子によって振動するホーンと、このホーンに形成され電子部品を被圧着面に押圧する圧着面と、この圧着面から前記ホーンの両端側へ等距離隔てられた位置において前記ホーンより突出する連結部と、この連結部の先端部に形成され前記ホーンをボンディング装置の昇降部材に固定する固定部とを備え、前記固定部を前記ホーンと一体的に設け、かつ前記固定部の上部を前記昇降部材に固定したことを特徴とする電子部品のボンディング装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の電子部品のボンディング装置は、電子部品に当接して電子部品を被圧着面に押圧しながら振動を付与して被圧着面に圧着する電子部品のボンディングツールを備えた電子部品のボンディング装置であって、前記ボンディングツールが、振動子によって振動するホーンと、このホーンに形成され電子部品を被圧着面に押圧する圧着面と、この圧着面から前記ホーンの両端側へ等距離隔てられた位置において前記ホーンより突出する連結部と、この連結部の先端部に形成され前記ホーンをボンディング装置の昇降部材に固定する固定部とを備え、前記固定部を前記ホーンと一体的に設け、かつ前記固定部の上部を前記昇降部材に固定した。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】

【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
本発明によれば、ボンディングツールのホーンより突出する連結部と、この連結部の先端部に形成されホーンをボンディング装置の昇降部材に固定する固定部とを備え、前記固定部を前記ホーンと一体的に設け、かつ前記固定部の上部を前記昇降部材に固定したことにより、固定部に励起された曲げ振動のホーン本体への伝達を抑制し、ホーンの曲げ振動による上下方向の変位の発生を抑えることができる。